

2024年7月期第3四半期 決算概要

サムコ株式会社

証券コード: 6387 東証プライム

24/7月期第3Qの実績

(2023.8.1 ~ 2024.4.30)

24/7月期第3四半期 業績

- 売上高 57.5億円(前年同期比+3.3%)
- 営業利益 12.9億円(前年同期比△1.8%)
 - 営業利益率22.4%。
- 受注高 56.6億円(前年同期比△11.1%)
 - 受注残高53.2億円。(前年同期比△8.7%)

24/7月期第3Q 実績報告

(単位:百万円)

		23/7月期3Q 実績	24/7月期3Q 実績	前年同期比
売上高	Net Sales	5,576	5,759	3.3 %
売上総利益	Gross Profit	2,791	2,852	2.2 %
売上高総利益率	Gross Profit Ratio	50.1 %	49.5 %	—
営業利益	Operating Profit	1,314	1,291	△ 1.8 %
営業利益率	Operating Profit Ratio	23.6 %	22.4 %	—
経常利益	Ordinary Profit	1,349	1,384	2.6 %
当期純利益	Net Income	966	972	0.6 %

- ▶ 原材料価格の上昇はあるものの、原価低減や操業度向上などにより、売上高総利益率は高水準を維持。

24/7月期第3Q 装置別売上高

(単位:百万円)

	23/7月期3Q		24/7月期3Q		
	売上高	構成比	売上高	前年同期比	構成比
CVD装置	1,000	17.9 %	1,135	13.5 %	19.7 %
エッチング装置	2,631	47.2 %	3,192	21.4 %	55.5 %
洗浄装置	569	10.2 %	456	△ 19.9 %	7.9 %
部品・メンテナンス	1,376	24.7 %	975	△ 29.1 %	16.9 %
合計	5,576	100.0 %	5,759	3.3 %	100.0 %

【CVD装置】 半導体レーザー向けや高周波デバイス向け(化合物半導体分野)での販売。

【エッチング装置】 半導体レーザー向け、高周波デバイス向け、パワーデバイス向け(化合物半導体分野)、
欠陥解析向け(シリコン半導体分野)での販売。

【洗浄装置】 高周波デバイス向けや半導体レーザー向け(化合物半導体分野)での販売。

24/7月期第3Q 用途別売上高

(単位:百万円)

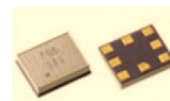
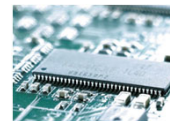
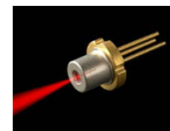
	23/7月期3Q		24/7月期3Q		
	売上高	構成比	売上高	前年同期比	構成比
化合物半導体分野	1,600	28.7 %	2,248	40.5 %	39.1 %
シリコン半導体分野	679	12.2 %	1,021	50.3 %	17.7 %
電子部品分野	737	13.2 %	384	△ 47.9 %	6.7 %
ヘルスケア関連分野	118	2.1 %	64	△ 45.9 %	1.1 %
その他	1,064	19.1 %	1,065	0.1 %	18.5 %
部品・メンテナンス	1,376	24.7 %	975	△ 29.1 %	16.9 %
合計	5,576	100.0 %	5,759	3.3 %	100.0 %

当第2四半期決算より、当社の事業形態を分かりやすく反映させるため、用途区分を変更しております。
(詳細は次ページ参照ください)

用途別売上高区分

当第2四半期決算より区分を変更しております

用途	概要
化合物半導体分野	GaN(窒化ガリウム)、GaAs(ガリウムヒ素)、InP(インジウムリン)、SiC(炭化シリコン)などの化合物を材料に用いた半導体デバイスの加工用途であります。化合物半導体はLEDや半導体レーザーといった光デバイス、電力の制御や増幅に使われるパワーデバイスや高速通信を実現するHEMT(High Electron Mobility Transistor=高電子移動度トランジスタ)などの高周波デバイスに用いられます。
シリコン半導体分野	シリコンウェハの欠陥解析及びシリコン半導体に関する加工用途であります。
電子部品分野	半導体を除く電子部品の加工用途であります。主にMEMS(Micro Electro Mechanical Systems=微小電気機械システム)、コンデンサ、インダクタ、各種センサー、高周波フィルターが含まれます。
ヘルスケア関連分野	マイクロ流体デバイスなどヘルスケアに関する加工用途であります。
その他	大学等の共用設備向けの装置など上記以外の加工用途であります。
部品・メンテナンス	部品・メンテナンスに関する売上であります。



第45期第2四半期 決算短信(2024.3.13提出)より

24/7月期第3Q 目的別売上高

(単位:百万円)

	23/7月期3Q		24/7月期3Q		
	売上高	構成比	売上高	前年同期比	構成比
生産用	2,282	40.9 %	2,125	△ 6.9 %	36.9 %
研究開発用	1,918	34.4 %	2,658	36.6 %	46.2 %
部品・メンテナンス	1,376	24.7 %	975	△ 29.1 %	16.9 %
合計	5,576	100.0 %	5,759	3.3 %	100.0 %

【生産用】 エッチング装置を中心に、半導体レーザー、欠陥解析向けなどで販売。

【研究開発用】 半導体レーザー、高周波デバイス、パワーデバイス、多目的研究開発、共用設備への販売。

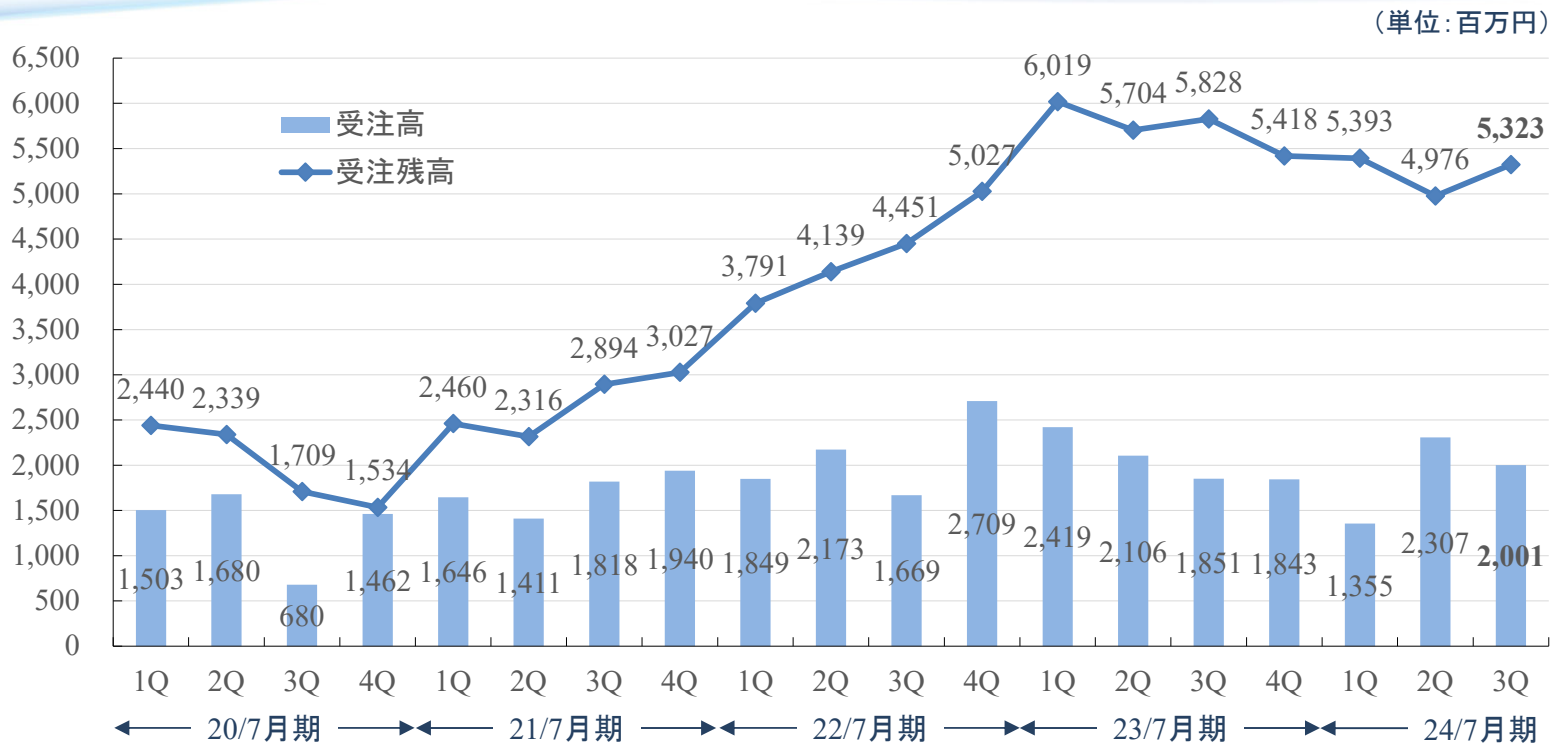
24/7月期第3Q 地域別売上高

(単位:百万円)

	23/7月期3Q		24/7月期3Q		
	売上高	構成比	売上高	前年同期比	構成比
(国内)	3,550	63.7 %	3,196	△ 10.0 %	55.5 %
(海外合計)	2,026	36.3 %	2,562	26.5 %	44.5 %
アジア	1,564	28.1 %	2,036	30.1 %	35.4 %
北米	397	7.1 %	523	31.6 %	9.1 %
欧州	63	1.1 %	2	△ 95.7 %	0.0 %
その他	—	—	0	—	0.0 %
合計	5,576	100.0 %	5,759	3.3 %	100.0 %

- 海外売上高比率 44.5% (通期計画は43.4%)。
- アジア市場: 中国1,328百万円、韓国424百万円、台湾196百万円、以下 インド、フィリピン、シンガポールほか。
- 北米市場: コロナ後の落ち込みから挽回。

受注環境（受注高、受注残高）の変化



24/7月期事業計画

(2023.8.1 ~ 2024.7.31)

中期経営計画 目標数値

(単位:百万円)

	23/7月期 実績	24/7月期 計画			25/7月期 計画
		上半期 実績	下半期 計画	通期	
売上高	7,830	4,105	4,394	8,500	11,000
売上総利益	3,869	2,052	2,072	4,125	5,180
営業利益	1,858	1,012	977	1,990	2,600
経常利益	1,927	1,063	946	2,010	2,610
当期純利益	1,366	747	622	1,370	1,780
海外売上高比率	34.3 %			43.4 %	45.5 %
R O E	12.9 %			11.8 %	13.8 %
1株当たり当期純利益(円)	170.07			170.56	221.4

参考資料

会社概要

商号	サムコ株式会社 Samco Inc.
代表者	代表取締役会長兼CEO 辻 理(つじ おさむ) 代表取締役社長兼COO 川邊 史(かわべ つかさ)
設立	1979年(昭和54年)9月1日
本社所在地	〒612-8443 京都市伏見区竹田藁屋町36
事業内容	半導体等電子部品製造装置の製造及び販売
売上高	78億3,059万円(2023年7月期)
従業員	175名(2024年1月)
証券コード	6387(東京証券取引所プライム市場)



左:川邊 史、右:辻 理



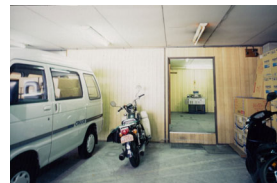
最新の会社案内は[こちら](#)



当社のビジネスモデルは[こちら](#)

沿革(創業～2010年)

- 1979年9月 半導体製造装置の製造及び販売を目的として株式会社サムコインターナショナル研究所を設立
- 1980年7月 半導体プロセス用大型CVD(Chemical Vapor Deposition)装置の開発、販売を開始
- 1984年7月 東京都品川区に東京出張所(現東日本営業部)を開設
- 1987年2月 米国カリフォルニア州にオプトフィルムズ研究所を開設
- 1997年11月 キリンビール株式会社と共同で、プラスチックボトルにDLC(ダイヤモンド・ライク・カーボン)膜を形成する技術を開発
- 2001年5月 日本証券業協会に株式を店頭上場
- 2004年12月 株式会社サムコインターナショナル研究所からサムコ株式会社へ社名を変更
- 2010年4月 ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所JASDAQ市場(2013年7月より東京証券取引所JASDAQ(スタンダード))に上場



沿革の詳細は[こちら](#)

沿革(2011年～現在)

2013年7月	東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)から市場第二部へ市場変更
2014年1月	東京証券取引所市場第二部から同第一部銘柄に指定
2014年5月	リヒテンシュタイン公国UCP Processing Ltd.の株式90%を取得し子会社化(samco-ucp AGに社名変更)
2016年9月	Aqua Plasmaを用いたプラズマ洗浄装置AQ-2000の開発、販売を開始
2020年7月	第二生産技術棟内にCVD装置のデモルームを開設
2021年12月	電子デバイス製造向けクラスターツールシステム「クラスターH TM 」の販売を開始
2022年3月	第二研究開発棟内にナノ薄膜開発センターを立ち上げ
2022年4月	東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所市場第一部からプライム市場へ移行



沿革の詳細は[こちら](#)

国内拠点、海外拠点



京都地区



本社



研究開発センター



第二研究開発棟



製品サービスセンター



生産技術研究棟



第二生産技術研究棟



海外営業・サービス拠点(計11拠点)

海外売上高比率34.3%(2023年7月期実績)

現地の営業・サービス人員を強化し、海外市場の開拓を図る。

⇒インド・ベンガルールオフィスを開設(2022年7月)

各事業拠点の詳細は[こちら](#)

製品ラインナップ



deposition

■CVD (Chemical Vapor Deposition) 装置

- ALD (Atomic Layer Deposition) 装置
- プラズマCVD装置
- 液体ソースCVD®装置



etching

■ドライエッチング装置

- ICP (Inductively Coupled Plasma) エッチング装置
- シリコン深掘り装置
- RIE (Reactive Ion Etching) 装置



surface
treatment

■ドライ洗浄装置

- Aqua Plasma® クリーナー
- プラズマクリーナー
- UVオゾンクリーナー

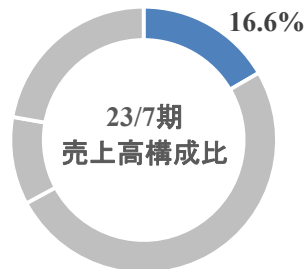


品目別売上高 CVD装置



装置ラインナップ

- ・ALD (Atomic Layer Deposition) 装置
- ・プラズマCVD装置
- ・液体ソースCVD®装置



概要

反応性の気体を基板上に供給し、化学反応によって薄膜を形成する装置で、一般に半導体、電子部品製造のための半導体膜、絶縁膜、金属膜などを形成するために使われます。当社が開発したLS (Liquid Source)-CVD装置では、引火爆発性のあるガスを使用せず安全性に優れた液体原料を用いて、低温で均一性に優れた薄膜を高速で形成することが可能であります。

2015年12月から販売を開始した原子層堆積装置 (ALD = Atomic Layer Deposition) はCVD装置に分類しております。ALD装置は、反応室に有機金属原料と酸化剤を交互に供給し、表面反応のみを利用して成膜を行う装置であり、高い膜厚制御性と良好な段差被覆性を実現することが可能であります。

第44期有価証券報告書(2023.10.24提出)より



CVD装置の詳細は[こちら](#)



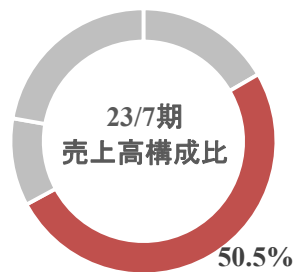
CVD装置とは ⇒ [こちら](#)
(半導体製造装置入門より)

品目別売上高 エッチング装置



装置ラインナップ

- ・ICP (Inductively Coupled Plasma) エッチング装置
- ・シリコン深掘り装置
- ・RIE (Reactive Ion Etching) 装置
- ・XeF₂ドライエッチング装置



概要

各種半導体基板上の半導体薄膜、絶縁膜をはじめ微細加工が必要な材料をドライ加工する装置で、反応性の気体をプラズマ分解し、目的物と反応させて蝕刻いたします。当社独自のトルネードICP (Inductively Coupled Plasma = 高密度プラズマ) を利用するエッチング装置では、高密度プラズマを安定して生成し、高速で高精度の微細加工が可能です。

第44期有価証券報告書(2023.10.24提出)より



エッチング装置の詳細は[こちら](#)



エッチング装置とは [⇒こちら](#)
(半導体製造装置入門より)

品目別売上高 洗浄装置



surface
treatment

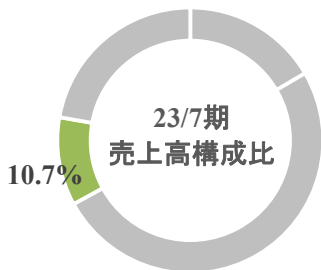
装置ラインナップ

- ・Aqua Plasma[®] クリーナー
- ・プラズマクリーナー
- ・UVオゾンクリーナー

概要

実装基板や各種半導体基板などを溶液を用いずドライ洗浄する装置で、減圧下で反応性の気体をプラズマ放電させて処理する装置や紫外線と高濃度オゾンの併用で処理する装置などがあります。当社のドライ洗浄装置は、ウエット洗浄では難しい超精密洗浄を高効率で行うことが可能であります。

2016年9月より販売を開始した水蒸気(H₂O)を用いたプラズマ処理装置であるAqua Plasma(アクアプラズマ)洗浄装置は、金属酸化膜の還元、有機汚れの洗浄、樹脂接合、超親水化などの表面処理を、安全で環境に優しく行うことが可能であります。 第44期有価証券報告書(2023.10.24提出)より



洗浄装置の詳細は[こちら](#)



洗浄装置とは ⇒ [こちら](#)
(半導体製造装置入門より)

品目別売上高 部品・メンテナンス

主な内訳

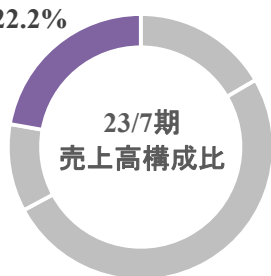
- ・部品、消耗品
- ・修理、改造
- ・移設、作業
- ・メンテナンス

概要

当社装置の納品後のアフターサービスに係る売上を、部品・メンテナンスの売上高として計上しております。交換用の部品や消耗品をはじめ、装置の修理や改造、また装置の移設やそれに伴う作業費、メンテナンス費用等があります。

第44期有価証券報告書(2023.10.24提出)より

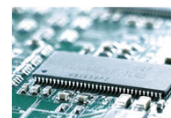
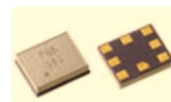
22.2%



旧用途別売上高区分 当第1四半期決算までの区分

用途	概要
オプトエレクトロニクス分野	主に化合物半導体から作られるLED(Light Emitting Diode=発光ダイオード)やマイクロLED、LD(Laser Diode=半導体レーザー)、面発光レーザー(VCSEL)などの発光デバイスのほか、電気信号を光信号に変換したり、逆に光信号を電気信号に変換したりする光通信用デバイスなどに関する分野。
電子部品分野	パワーデバイス・高周波デバイス・各種センサー・MEMS(Micro Electro Mechanical Systems=微小電気機械素子)・SAW(Surface Acoustic Wave=弾性表面波)デバイス・量子デバイスなどに関する分野。
シリコン分野	三次元LSI(Large Scale Integrated circuit)・三次元パッケージやウェハー欠陥解析などに関する分野。
実装・表面処理分野	ICのパッケージングの洗浄や表面処理に関する分野であります。高密度実装に対応するために基板はますます小型化、薄型化、多ピン化しており、高度な洗浄機能が要求されております。
表示デバイス分野	有機EL(Electro Luminescence)、LCD(Liquid Crystal Display=液晶表示素子)、VR(Virtual Reality)ディスプレイなどに関する分野。
その他分野	上記以外の分野。
部品・メンテナンス	部品・メンテナンスに関する分野。

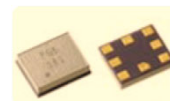
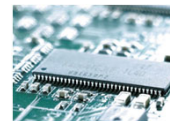
第44期有価証券報告書(2023.10.24提出)より



用途別売上高区分

当第2四半期決算より区分を変更しております

用途	概要
化合物半導体分野	GaN(窒化ガリウム)、GaAs(ガリウムヒ素)、InP(インジウムリン)、SiC(炭化シリコン)などの化合物を材料に用いた半導体デバイスの加工用途であります。化合物半導体はLEDや半導体レーザーといった光デバイス、電力の制御や増幅に使われるパワーデバイスや高速通信を実現するHEMT(High Electron Mobility Transistor=高電子移動度トランジスタ)などの高周波デバイスに用いられます。
シリコン半導体分野	シリコンウェハの欠陥解析及びシリコン半導体に関する加工用途であります。
電子部品分野	半導体を除く電子部品の加工用途であります。主にMEMS(Micro Electro Mechanical Systems=微小電気機械システム)、コンデンサ、インダクタ、各種センサー、高周波フィルターが含まれます。
ヘルスケア関連分野	マイクロ流体デバイスなどヘルスケアに関する加工用途であります。
その他	大学等の共用設備向けの装置など上記以外の加工用途であります。
部品・メンテナンス	部品・メンテナンスに関する売上であります。



第45期第2四半期 決算短信(2024.3.13提出)より

当社製品が用いられるアプリケーション(例)



MEMS



TSV



SiCパワーデバイス

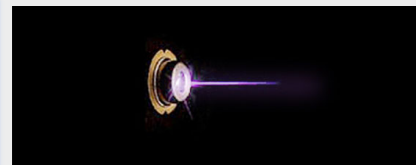


GaNパワーデバイス



LED

様々なアプリケーションの製造工程に
当社の製品が使用されています。



半導体レーザ(LD)



光導波路



フォトニック結晶



GaAs高周波デバイス



SAWデバイス

事業領域 化合物半導体の例

化合物半導体は、複数の異なる元素を組み合わせることで、シリコンのような単元素の半導体では実現できない特性を得ることができます。

高速で動作する、高い耐熱性、低消費電力、発光するなどの優れた特性を持っており、スマートフォンの高周波デバイスやLD、LED、次世代パワーデバイスなどの材料として利用されています。

デバイスの例	材料の例	最終製品・用途の例
LD(半導体レーザー)	GaAs、InGaAsP、InP	スマートフォン顔認証システム、自動車の自動運転システム、無線基地局・衛星、光通信
LED、マイクロLED	GaN、AlInGaP、GaP	液晶ディスプレイ、照明、自動車ヘッドライト
パワーデバイス	SiC、GaN、Ga ₂ O ₃	鉄道車両インバーター、電気自動車の充電ユニット、データセンター、ノートパソコン等の急速充電器

地域別売上高区分

当社では、当社の製品が使用される地域(国)によって、売上高を以下の地域に区分しております。

地 域	対象となる国
日 本	日本国内
アジア	台湾、中国、韓国、シンガポール、マレーシア、タイ、ベトナム、インド ほか
北 米	米国、カナダ、メキシコ
欧 州	ブルガリア、ドイツ、イギリス、フィンランド、ポルトガル、スペイン、イタリア、トルコ ほか
その他	オーストラリア、エジプト ほか

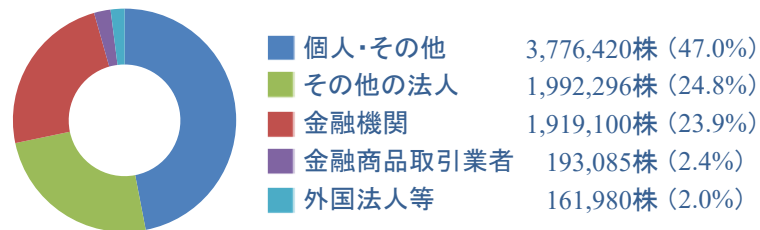
当社 第44期有価証券報告書(2023.10.24提出)より

株式の状況 (2024年1月末時点)

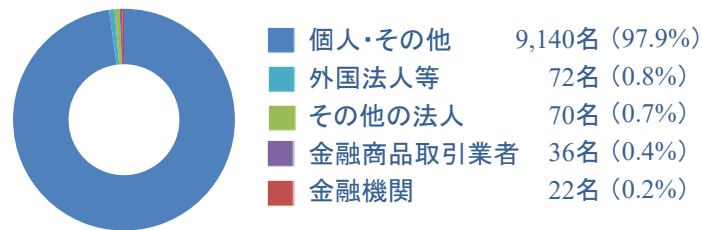
- ・発行可能株式総数 14,400,000株
- ・発行済株式の総数 8,042,881株
- ・株主数 9,340名
- ・大株主の状況

株主名	持株数 (株)	持株比率 (%)
一般財団法人サムコ科学技術振興財団	1,000,000	12.4
辻 理	863,707	10.7
サムコエンジニアリング株式会社	850,282	10.6
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	665,600	8.3
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	377,300	4.7
辻 一美	201,465	2.5
野村信託銀行株式会社(投信口)	161,000	2.0
株式会社三菱UFJ銀行	129,600	1.6
サムコ従業員持株会	104,738	1.3
立田 利明	103,099	1.3

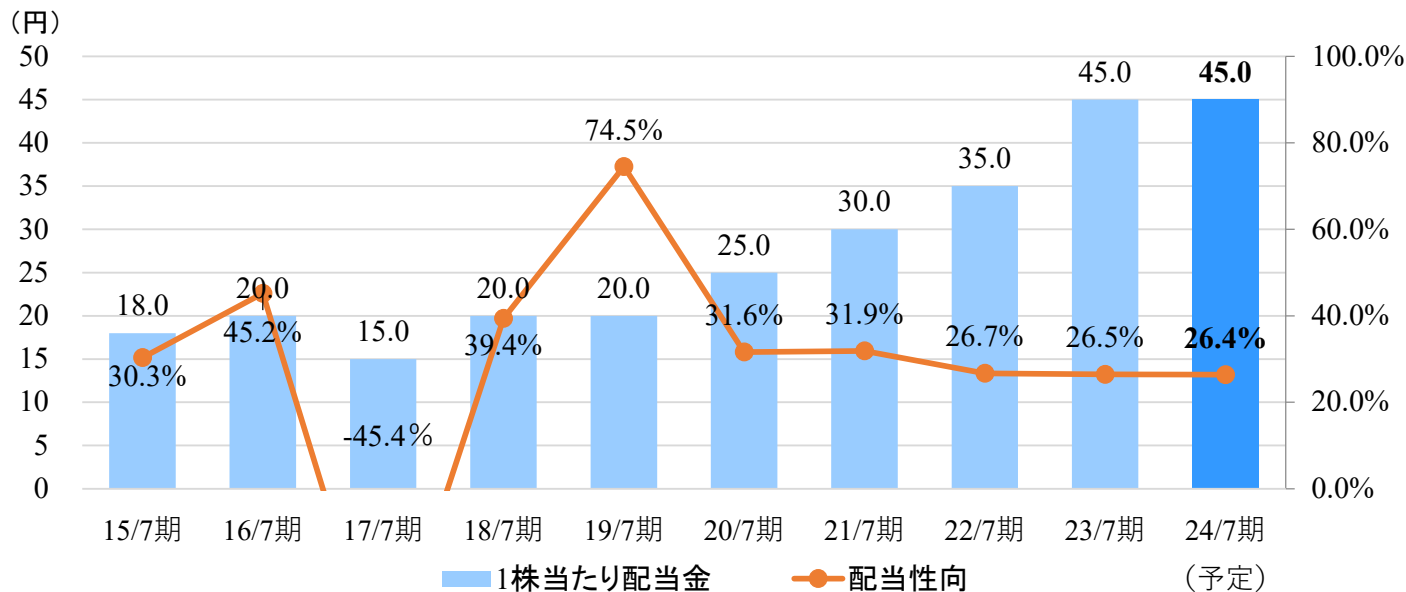
- ・所有者別株式分布状況(株式数ベース)



- ・所有者別株式分布状況(株主数ベース)



1株当たり配当金、配当性向 推移



経営体質の強化と研究開発のための設備投資等のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続する基本方針のもと、余剰資金については業績連動的な配当の考え方を合わせて取り入れております。

ESG・サステナビリティ



持続可能な社会の実現に向けて サムコの取り組み

経営理念 ～薄膜技術で世界の産業科学に貢献する～

E
環境

《気候変動・脱炭素への取り組み》

- ・TCFD提言に基づいた情報開示。ESG委員会の活動による気候変動への対応状況把握、対策。
- ・環境方針(2006年制定)に沿った取り組みを実施。

《環境配慮型製品》

- ・省エネ・脱炭素を支えるLED、次世代パワーデバイスの製造などを支える装置メーカー。
- ・コア技術である最先端の“薄膜技術”をベースに世界中の製造現場や研究者へ装置を提供。
- ・主な取り組みテーマ ①製品容積の減少、②消費エネルギーの削減、③会社消費電力量の削減、④グリーン調達、⑤廃棄物の削減

S
社会

《事業を通じた社会的価値の創造》

- ・顧客価値、取引先価値、社会的価値、株主価値、従業員価値の創造

《社会貢献、地域貢献》

- ・サムコ科学技術振興財団による若手研究者への支援活動
- ・京都工繊繊維大学への寄附講座
- ・従業員、会社からの寄付金活動。(日本赤十字社、京都大学ほかノウクライナ支援、トンガ大津波支援)

G
ガバナンス

《ガバナンス体制、ダイバーシティ》

- ・役員11名中、社外役員5名
- ・取締役会の実効性評価による改善、検討。
- ・多様な人材確保。(女性管理職の登用、外国籍社員の積極採用、中途採用含めた中核人材の多様性、シニア社員の活躍)

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

当社が重点的に取り組むSDGs



上記の取り組みに限らず、様々なチャレンジを続けることで、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

各取り組みの詳細はこちら

サステナビリティに関する取り組み

取り組みテーマ	概要
製品容積の減少	半導体製造装置の製造現場では、多大な電力を要するクリーンルームでの効率的な装置配置が不可欠です。そのためには、フットプリントの削減が重要なポイントとなります。更に小さなサイズの装置とすることで納品時における移送コストの削減を行うことができます。
消費エネルギーの削減	より少ない電力消費で当社装置を稼働できるよう省電力が可能となる部品の選択や構成の見直しなどを恒常的に行ってまいります。
会社消費電力量の削減	当社業務活動における電力消費、温室効果ガスの排出量削減を目指した取り組みを行ってまいります。
グリーン調達	当社では、環境に配慮した原材料・部品を優先的に調達するグリーン調達を、調達先企業と協力して推進しております。
廃棄物の削減	事業活動に伴い排出される廃棄物の量の削減・リサイクル製品の利用促進に継続的に取り組んでおります。

各取り組みの詳細は[こちら](#)

TCFD対応

気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)



G20財務大臣・中央銀行総裁会議の要請を受け、金融安定理事会(FSB)により2015年12月に設立された「Task Force on Climate-related Financial Disclosures」の略称。

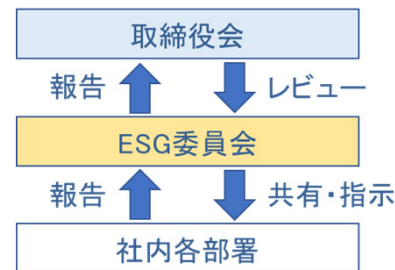
「ESG委員会」より、ガバナンス、戦略、リスク管理、指標と目標について当社ホームページ上で開示。

ESG委員会

気候変動に係るリスク及び機会、自社の事業活動や収益に与える影響についてのデータ収集と分析を行うため、代表取締役社長を委員長とする「ESG委員会」設置。

⇒活動内容を取締役に年1回以上報告

⇒財務への影響や中長期経営計画への影響等に対する検討を行う。



[各取り組みの詳細はこちら](#)

省エネ、脱炭素社会実現を支えるサムコの技術



サムコの“薄膜技術”は省エネ・脱炭素を支えるLED、次世代パワーデバイスなどを支えています。

当社のコア技術である最先端の“薄膜技術”をベースに、SDGsに関連する環境・社会・ガバナンスの視点から研究開発、人材育成に注力。

最先端の製造装置を世界中の製造現場や研究者へ提供し、省エネ、脱炭素社会の実現に貢献していきます。

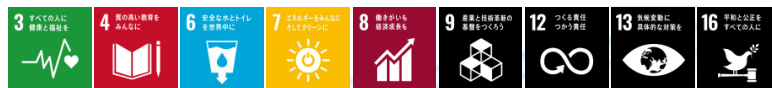
サムコとSDGsの関わり

- ・当社の主な事業領域である半導体・電子部品製造装置事業は、SDGsの目標を達成するためには欠かせない技術です。
- ・SDGsの17の目標では、経済、産業、社会等の課題を取り扱っていますが、当社では、創業以来、「企業の永続的な発展を追求し、適正な利益を確保することにより、企業を取巻く利害関係者と共に成長する企業を目指して、薄膜技術で世界の産業科学に貢献する。」という経営理念を掲げて、社会への貢献に重きを置いてきました。

事業との関連性が高い以下の項目について、重点的に取り組んでまいります。







サムコのSDGsの取り組み例



	<ul style="list-style-type: none"> ・マイクロ流体チップ、医療用ドライ滅菌装置の製造に当社アクアプラズマ技術の寄与を目指す。 ・深紫外LED空気清浄機(コロナウィルス不活性化)製造に当社装置が寄与。 ・医療機器、エコーヘッドセンサーの製造に当社装置が寄与。 ・日本赤十字社への寄付。(ウクライナ支援、トンガ大津波支援等)
	<ul style="list-style-type: none"> ・国内外の大学(ODA案件を含む)・研究機関等における医療分野や科学分野の研究のために、幅広く当社装置を提供。 ・サムコ科学技術振興財団を通じ、基礎・応用研究に携わる研究者を支援。 ・京都工芸繊維大学にサムコ辻理寄附講座「先端材料科学講座」を開講。
	<ul style="list-style-type: none"> ・浄水場・家庭・職場・レストラン等での流水浄化用に水銀ランプの代替光源として、深紫外線LEDを利用した浄水器が製造。深紫外線LEDの製造に当社装置が寄与。
	<ul style="list-style-type: none"> ・省エネの切り札である次世代パワーデバイスの材料として期待されるSiC(炭化シリコン)、GaN(窒化ガリウム)、酸化ガリウム(Ga₂O₃)等の加工に当社装置が寄与。 ・高効率LED素子、マイクロLEDや、LD(レーザー)の製造のほか、太陽電池の研究開発用で当社装置を提供。
	<ul style="list-style-type: none"> ・当社はファブライト企業として、サプライヤーや協力工場と協業し、双方の事業発展を目指す。 ・勤続年数に応じた表彰のほか、業績への貢献に応じた賞を用意。 ・役職ごとの当社独自の人材育成プログラムを実施。 ・多様な人材確保。(女性管理職の登用、外国籍社員の積極採用、中途採用含めた中核人材の多様性、シニア社員の活躍)

サムコのSDGsの取り組み例



 <p>産業と技術革新の基盤をつくろう</p>	<p>産業と技術革新の基盤造りのため、以下の用途等に装置を提供</p> <ul style="list-style-type: none"> ・5G関連の高周波フィルター、高周波デバイスの製造やデータセンターなどVCSEL(面発光レーザー)を含む通信用LD(レーザー)用装置の製造。 ・自動運転用のセンシング技術(LIDAR)、各種センサーや宇宙衛星の探索用センサー機器の製造。 ・有機EL、マイクロLEDの製造。 ・超伝導デバイス、量子デバイスの研究開発用途。
 <p>つくる責任 つかう責任</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・人の健康や環境を守るために当社での製造過程、製品について適正な管理を実現する。 ・環境に調和するプロセス技術の開発と、製造から廃棄までを考慮した環境負荷軽減型の製品開発に努める。 ・省エネルギー、省スペースを基本とした製品を通じて環境負荷を低減。
 <p>気候変動に具体的な対策を</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・調達する原材料、部品について、環境影響を考慮するよう調達先に働きかけ、グリーン調達に注力。 ・エネルギーの効率的な利用および3Rに取り組む。 ・省エネルギー、省スペースを基本とした製品を通じて環境負荷を低減。
 <p>平和と公正をすべての人に</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・コーポレートガバナンス・コードに基づいた経営を実践。 ・管理職、新入社員を対象にしたコンプライアンス研修を定例的に実施。 ・コンプライアンス全体を統括する組織として代表取締役社長を委員長とする「内部統制委員会」を設置し、内部統制システムの構築、維持、向上を推進。

サムコの人材育成方針



1. 仕事は楽しく、面白くあるべきである。一所懸命に楽しく仕事をして、かつ面白い。そして良い結果がついてくる。そんな楽しく、面白い日々が日常である会社とする。
2. “学ぶ”を忘れない。学ぶことを常に念頭に置き、長きに渡り己を磨くことで自らの価値を高めてほしい。特に若手社員は30代までに能力向上に勤しむ癖をつけなければならない。
3. リスキングにより第一線で活躍できるスキルを身に付けることにより、70歳まで働ける企業としていく。シニア社員が十分社会貢献できるよう再教育することを会社の使命と考える。
4. 外国籍社員の採用を増やし、若手社員の海外経験を増やすことによりグローバル人材の育成を図る。
5. 階層別の教育訓練制度(部長塾、課長塾、成長塾)を発展的に継続し、多角的な視野で経営管理できる人材の育成を図る。
6. たえず組織の新陳代謝を図り、新たな細胞(多様な人材)を積極的に登用していく。人事異動は社員の層を厚くし、組織を重層化する目的もあり、新たな能力の開拓につなげる。女性社員も大きな戦力として、管理職で活躍をしてもらえるように環境を整備する。



資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応

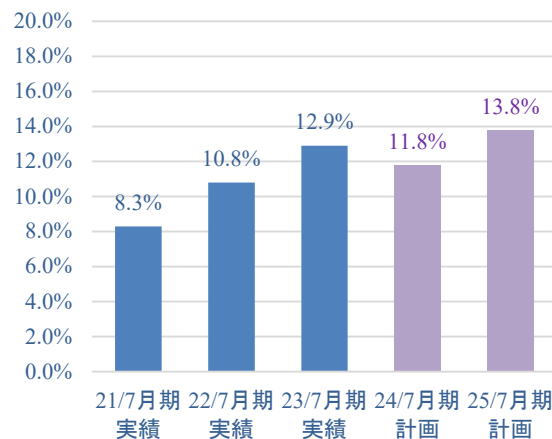
当社は、中長期的な経営指標として「装置製造原価率50%未満」「売上高営業利益率20%以上」「海外売上高比率50%以上」を掲げ、収益性と成長性を重視した経営の実現に向け対応しております。

当社の2023年7月期(第44期)のROEは12.9%であり、第45期には11.8%、第46期には13.8%とする計画であります。また、「資本コスト」については、その概念や計算方法について統一的な基準が示されておらず、一般的な指標になっていないことより、当社の経営指標や開示情報には用いておりませんが、新規事業等への新たな投資については現状のROE水準を意識した経営を実践しております。

なお、当社の2023年7月末時点のPBRは3.83倍となっており、株価についても意識した経営を継続いたします。

コーポレートガバナンス報告書(2024.4.4提出)より

ROEの実績(3期分)、計画(2期分)



ROE
(Return On Equity)
自己資本当期純利益率

×

PER
(Price Earnings Ratio)
株価収益率

=

PBR
(Price Book-value Ratio)
株価純資産倍率

コーポレートガバナンス報告書は[こちら](#)

株主・投資家との対話状況

基本方針

当社は、持続的な企業価値の向上のために、株主との間で建設的な対話を行うこととしております。株主との対話につきましては、代表取締役社長 川邊 史の管掌の下、専任部署である広報・IR室(2024年6月現在3名)を中心に、経理部、総務部、社長室などの関連部署と密接に連携しつつ、IR活動を行っています。また、対話に際しては内部規定に基づき未公表のインサイダー情報の管理を徹底しております。

対話を行った株主の概要 対象期間:2022年8月1日から2023年7月31日までの1年間

【機関投資家・アナリスト向け】

- ・1 on 1 ミーティング 118件(国内100件、海外18件)
- ・スモールミーティング 年5回
- ・機関投資家・アナリスト向け オンライン決算説明会 年2回(Zoomウェビナー形式/中間3月、期末9月)

【個人投資家向け】

- ・株主総会後の会社説明会 年1回(10月)
- ・第44期年次報告書にて株主アンケートを実施
- ・個人投資家からの電話・メール問い合わせ対応 随時

その他、対話の実例、取締役会に対するフィードバック、取り入れた事項などはHPIに掲載 ⇒ [株主・投資家との対話状況の詳細はこちら](#)

IRカレンダー



お問い合わせ

サムコ 株式会社

広報・IR室

E-mail : koho@samco.co.jp

URL : www.samco.co.jp



Better Tomorrow Driven by Thin Film Technology